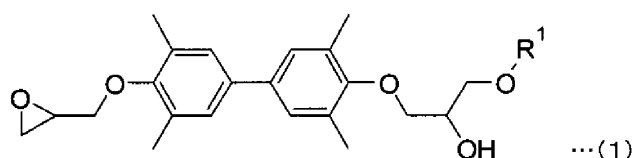


請求の範囲

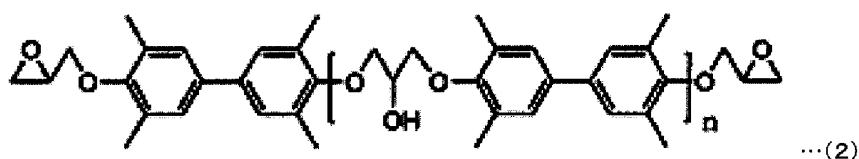
[請求項1] 下記式（１）で表されるエポキシ樹脂及び下記式（２）で表されるエポキシ樹脂を含むことを特徴とするエポキシ樹脂組成物（Ａ）。

[化1]



（式（１）中、R¹は炭素数１～６の直鎖の脂肪族炭化水素基を表す。）

[化2]



（式（２）中、nは０～１の整数を示す。）

[請求項2] 前記エポキシ樹脂組成物中の前記式（１）で表されるエポキシ樹脂の存在割合が０．０１～５．０重量％である請求項１に記載のエポキシ樹脂組成物（Ａ）。

[請求項3] 前記式（２）で表されるエポキシ樹脂において、n＝０のエポキシ樹脂の前記エポキシ樹脂組成物（Ａ）中の存在割合が８３．０～９０．０重量％及びn＝１のエポキシ樹脂の前記エポキシ樹脂組成物（Ａ）中の存在割合が２．０～９．９重量％である請求項１又は２に記載のエポキシ樹脂組成物（Ａ）。

[請求項4] 前記エポキシ樹脂組成物中の加水分解性塩素量が３００重量ppm以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載のエポキシ樹脂組成物（Ａ）。

[請求項5] 請求項１～４のいずれか１項に記載のエポキシ樹脂組成物（Ａ）１

00重量部に対し、硬化剤を0.01～1000重量部含むエポキシ樹脂組成物（B）。

[請求項6] 前記硬化剤がフェノール系硬化剤、アミン系硬化剤、酸無水物系硬化剤及びアミド系硬化剤からなる群から選ばれる少なくとも1種である請求項5に記載のエポキシ樹脂組成物（B）。

[請求項7] 前記エポキシ樹脂組成物（A）中のエポキシ樹脂とは異なるエポキシ樹脂を更に含む請求項5又は6に記載のエポキシ樹脂組成物（B）。

[請求項8] 請求項5～7のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物（B）を硬化させてなる硬化物。

[請求項9] 請求項5～7のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂組成物（B）を硬化させてなる電気・電子部品。